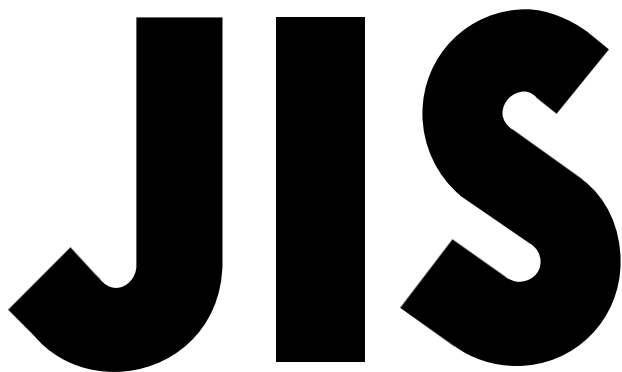




ソルダペーストー第3部：印刷性，粘度特性， だれ及び粘着性試験

JIS Z 3284-3 : 2024

(JWES/JSA)

令和6年1月22日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本産業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	松 橋 隆 治	東京大学
(委員)	安 部 泉	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	江 坂 行 弘	一般社団法人日本自動車工業会
	大 瀧 雅 寛	お茶の水女子大学
	木 村 一 弘	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	倉 片 憲 治	早稲田大学
	越 川 哲 哉	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	是 永 敦	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	椎 名 武 夫	千葉大学
	寺 家 克 昌	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	清 水 孝太郎	三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会社
	清 家 剛	東京大学
	高 辻 利 之	株式会社 AIST Solutions
	田 淵 一 浩	一般財団法人日本船舶技術研究協会
	千 葉 光 一	関西学院大学
	中 川 梓	一般財団法人日本規格協会
	久 田 真	東北大学
	廣 瀬 道 雄	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	星 川 安 之	公益財団法人共用品推進機構
	細 谷 恵	主婦連合会
	棟 近 雅 彦	早稲田大学
	村 垣 善 浩	神戸大学
	山 内 正 剛	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
	山 田 陽 滋	豊田工業高等専門学校

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 26.6.20 改正：令和 6.1.22

官 報 掲 載 日：令和 6.1.22

原 案 作 成 者：一般社団法人日本溶接協会

(〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 溶接会館 TEL 03-5823-6324)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 松橋 隆治)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 試験方法	2
4.1 ソルダペーストの印刷性試験	2
4.2 粘度特性試験	3
4.3 印刷時のだれ試験	6
4.4 加熱時のだれ試験	8
4.5 粘着性試験	9
附属書 JA（規定）ソルダペーストの特性評価表	11
附属書 JB（参考）JIS と対応国際規格との対比表	12
解 説	14

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人日本溶接協会（JWES）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS Z 3284-3:2014** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JIS Z 3284 規格群（ソルダペースト）は、次に示す部で構成する。

JIS Z 3284-1 第 1 部：種類及び品質分類

JIS Z 3284-2 第 2 部：はんだ粉末の形状、表面状態判定及び粒度分布測定試験

JIS Z 3284-3 第 3 部：印刷性、粘度特性、だれ及び粘着性試験

JIS Z 3284-4 第 4 部：ぬれ性、ソルダボール及び広がり試験

ソルダペースト

第3部：印刷性，粘度特性，だれ及び粘着性試験

Solder paste—Part 3: Test methods for printability, viscosity, slump and tackiness

序文

この規格は、2015年に第1版として発行された IEC 61189-5-3 を基とし、我が国の実情に合わせるため、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、附属書 JB に示す。また、附属書 JA は対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

この規格は、主として電気機器、電子機器、通信機器などの配線接続及びそれらの部品の接続などに用いるはんだ付用ソルダペーストのソルダペーストの印刷性試験，粘度特性試験，印刷時のだれ試験，加熱時のだれ試験及び粘着性試験について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

IEC 61189-5-3:2015, Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies—Part 5-3: General test methods for materials and assemblies—Soldering paste for printed board assemblies (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 5603 プリント回路用語

JIS K 5500 塗料用語

JIS K 8839 2-プロパノール（試薬）

JIS R 6252 研磨紙

JIS Z 3001-1 溶接用語—第1部：一般

JIS Z 3001-3 溶接用語—第3部：ろう接